

盈方微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

1、本次担保情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）于 2026 年 7 月 17 日与交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分（支）行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资金借款合同》，交通银行同意向联合无线香港提供融资额度人民币贰亿元整，额度使用期限自 2026 年 7 月 14 日至 2027 年 7 月 14 日，可循环使用。同日，公司及控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）分别与交通银行签署了《保证合同》，为联合无线香港履行债务提供保证担保，具体详见“四、担保合同的主要内容”。

2、担保额度的审议情况

公司分别于 2026 年 3 月 27 日、4 月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，公司和华信科分别为联合无线香港提供不超过人民币 90,000 万元、20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。公司分别于 2026 年 5 月 18 日、6 月 3 日召开第十三届董事会第九次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，公司和华信科分别为联合无线香港新增不超过 60,000 万元、40,000 万元的担保额度，

并授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。

以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批的担保额度	本次担保后已使用担保额度	本次担保后剩余可用担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	联合无线香港	51%	45.64%	150,000	57,100	92,900	21,276.93	41,276.93	650.14%	是
华信科	联合无线香港	-	45.64%	60,000	57,100	2,900	21,276.93	41,276.93	650.14%	是

注：保证范围详见“四、担保合同的主要内容”。

三、被担保人基本情况

公司名称：联合无线（香港）有限公司

注册号：2152532

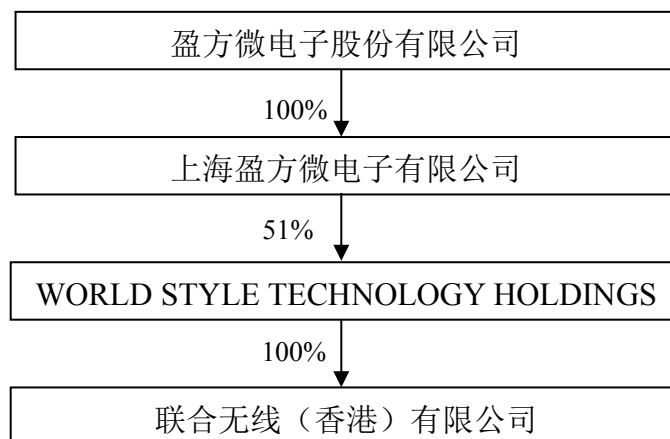
住所：3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

授权股本：100 万港币

发行股本：100 万港币

成立日期：2014 年 10 月 6 日

股权结构：联合无线香港是 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有 WORLD STYLE 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：



最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目名称	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	837,301,019.25	730,654,499.66
负债总额	440,547,707.66	333,505,345.00
其中：银行贷款总额	—	14,876,710.00
流动负债总额	440,547,707.66	333,505,345.00
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	396,753,311.59	397,149,154.66
项目名称	2025 年 1 月至 12 月（经审计）	2026 年 1 月至 3 月（未经审计）
营业收入	2,653,287,935.72	570,779,507.87
利润总额	21,737,000.14	10,935,808.99
净利润	18,301,629.56	9,278,303.16

联合无线香港不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

鉴于公司及华信科与交通银行分别签署的 2 份《保证合同》的主要内容基本一致（公司及华信科分别对联合无线香港提供同等担保），对 2 份《保证合同》的主要内容予以合并说明：

保证人：盈方微电子股份有限公司/深圳市华信科科技有限公司

债权人：交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分（支）行

1、担保的主债权：保证人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。

本合同项下被担保的主债权在全部主合同下最后一笔主债权的发生日（“主债权确定日”）确定，债权人根据主合同取消全部授信额度的，取消全部授信额度之日为主债权确定日。主债权确定日当日及之前发生的主债权及其持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用均属本合同保证的范围。

2、担保的最高债权额：保证人为债权人与债务人在 2026 年 7 月 14 日至 2027 年 7 月 14 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：（1）担保的主债权本金余额最高额（币种及大写金额）：人民币贰亿元整，本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额，（2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。

前款所称主合同指：债权人与债务人签订的全部授信业务合同。

本金余额是指以下任一或两项之和：i 债权人在主合同项下发放且债务人尚未偿还的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款本金之和；ii 债权人在主合同项下开立且仍有效的银行承兑汇票、信用证或担保函金额之和以及债权人在前述银行授信业务项下已垫付且债务人尚未偿付的金额之和。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

5、保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间

按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

6、合同的生效：本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章；保证人为自然人的，保证人签名；（2）债权人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章。

五、董事会意见

公司及华信科本次为联合无线香港提供的担保主要为满足其日常经营周转的需求，联合无线香港系公司控股子公司 WORLD STYLE 的子公司，舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为 WORLD STYLE 的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，其于 2026 年 3 月 27 日出具了《反担保函》，针对公司本次为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。联合无线香港目前经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保及反担保的风险处于公司可控制范围内，因此本次担保联合无线香港其他股东未提供反担保，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司的担保额度总金额为 63.5 亿元。截至本公告披露日，除本公告所述担保外，公司及其控股子公司担保总余额为 63,327.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1400.80%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、公司与交通银行签署的《保证合同》；
- 2、华信科与交通银行签署的《保证合同》；
- 3、联合无线香港和交通银行签署的《流动资金借款合同》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 18 日